

## UMEMSME-MNOIC セミナー

日時：2013年5月30日(木) 13:00～17:00

場所：産業技術総合研究所つくば東事業所 4G棟 1F 国際セミナー室

### プログラム

13:00～13:30 「ドライ犠牲膜エッチングプロセス技術の微細構造 MEMS への適用」  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

産業機器販売事業部 プロセス機器技術部 技術第一課 山本 仁 氏

「大口径ウェハ対応 2D/3D ウェハ外観検査装置のご紹介」

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

産業機器販売事業部 プロセス機器技術部 技術第二課 荒井 大輔 氏

13:30～14:00 「東芝機械の微細加工ソリューション

ー高輝度LEDへの応用と大面積微細パターン形成への展開ー」

東芝機械株式会社 ナノ加工システム事業部 ナノ加工システム技術部

ナノインプリント技術開発担当 マネージャ 大友 明宏 氏

14:00～14:30 「表面活性化による低温・高精度WOW、COW接合装置」

ボンドテック株式会社 代表取締役 山内 朗 氏

14:30～15:00 MEMS 微細加工ライン見学（希望者のみ）

15:00～16:00 「EVG Technologies for Permanent & Temporary Bonding and  
Nano Imprint Lithography」

EV Group Inc., Business Development Manager – MEMS, Eric Pabo 氏

16:00～17:00 「先鋭マイクロバンプを用いた LSI チップ低温接合技術」

九州大学大学院 システム情報科学研究院

情報エレクトロニクス部門 浅野 種正 教授

17:00～ 懇親会